

ワイヤーボンディング検査

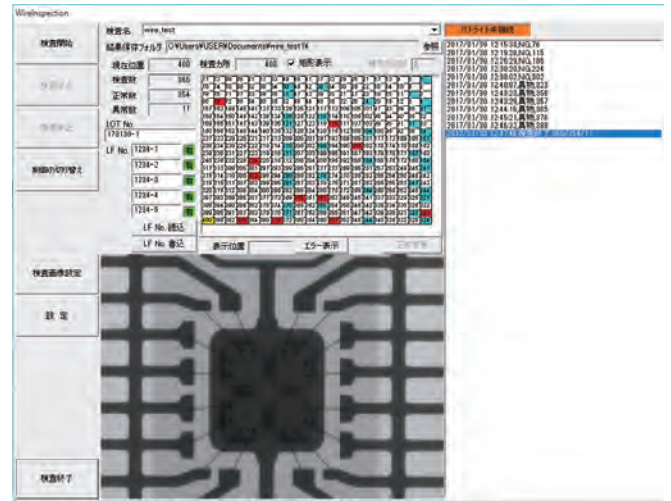
X線撮影画像により、ICチップ内部の画像を診断し、ワイヤーボンディング配線の断線、ショート、曲がり等の、不良判定する技術を開発しました。この技術を活用することで、IC内部で発生する不良検査が可能になります。

概要

- 開発したワイヤー検査ソフト(WireInspection)とX線検査ソフト(BSFM)の機能と連結することにより、IC内部画像を検査
- 被検査体、検査仕様を基にカスタムでソフト製作

適用用途

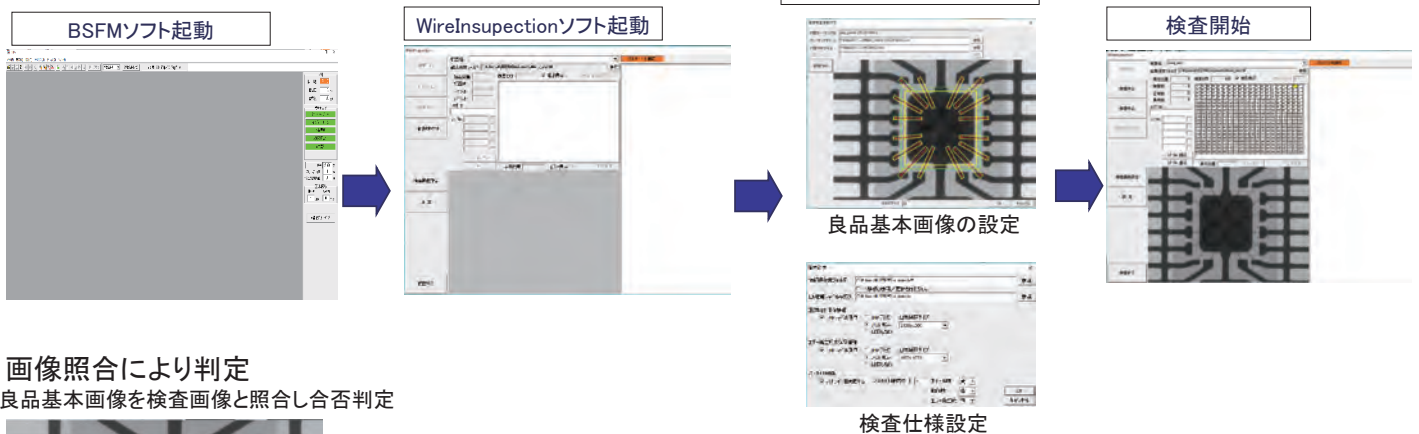
- ワイヤーボンディング後の工程(ICモールド加工等)で、発生するICチップ内部の不良検査。
- ロットアウト製品の再検査。
- 製造ロット毎の、仕上がり確認



WireInspectionソフト画面

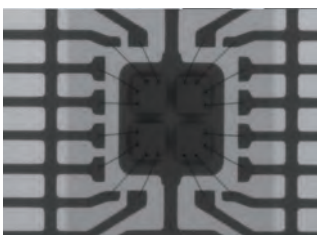
WireInspectionソフトの概要

検査の流れ

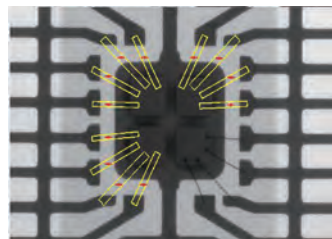


画像照合により判定

良品基本画像を検査画像と照合し合否判定



画像を照合



【お問い合わせ先】

株式会社ビームセンス
BEAMSENSE CO., LTD.

〒564-0041 大阪府吹田市泉町2-19-16

TEL/FAX: 06-6384-9563 URL: <http://beamsense.co.jp/>

2017.01.30